

华海清科股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

2024 年上半年，专项行动方案实施进展及成效如下：

一、坚持自主创新，聚焦主业提升核心竞争力

公司始终坚持以技术创新为企业发展驱动力，通过持续推进新产品、新工艺的开发，深耕集成电路制造上游产业链关键领域，保证了科技创新成果的持续输出和市场竞争力的稳步提升。2024 年上半年，公司在核心技术自主创新、新产品研发及布局、强化产业链协同效应等方面进一步加强行动力，具体包括：

1、持续推进新产品新工艺开发，积极服务产业前沿第一线

2024 年上半年，公司以更先进制程、更高产能、更低成本为重要突破方向，一方面基于现有产品不断进行更新迭代，另一方面积极布局新技术新产品的开发拓展，在 CMP 装备、减薄装备及其他产品方面取得了积极成果，持续保持高水平科技创新成果的输出。

公司推出的全新抛光系统架构 CMP 机台 Universal H300 已经实现小批量出货；12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile - GP300 已取得多个领域头部企业的批量订单，获得客户的高度认可；12 英寸晶圆减薄贴膜一体机 Versatile - GM300 已发往国内头部封测企业进行验证；满足集成电路、先进封装等制造工艺的 12 英寸晶圆边缘切割设备 Versatile-DT300 发往多家客户进行验证；应用于 4/6/8 英寸化合物半导体的刷片清洗装备已实现首台验收等，新技术、新产品布局拓展顺利。

2、坚持核心技术自主创新，不断加大研发投入力度

公司坚持“正向设计”的研究开发理念，始终以核心技术的自主创新引领公

司创新工作的开展，依托“国家企业技术中心”、“院士专家工作站”、“博士后科研工作站”等科研创新平台，持续加大自主研发力度，2024年上半年，研发投入达17,537.78万元，同比增长26.43%，不断提升、丰富在CMP、减薄、划切、清洗、膜厚测量等核心技术体系的覆盖，建立了核心技术的知识产权保护体系，截至2024年6月30日，公司拥有国内外授权专利388项，其中发明专利203项、实用新型专利185项，拥有软件著作权29项。

2024年上半年，公司持续研制面向更先进制程和更多适用领域的CMP装备，在第三代化合物半导体、先进逻辑芯片和存储芯片等领域技术实现进一步突破，市场占有率不断提升；用于验证关键技术、开发高级软硬件功能、可探索验证减薄新工艺的测试平台已投入使用，为后续其他减薄机型研发定型奠定基础；开展湿法设备关键系统及核心部件研发，提高公司整体清洗工艺性能；研制集成电路设备相关核心零部件以及先进制程关键零部件，满足集成电路精密制造需求，提高国产化率。

同时，公司和清华大学共同完成的“集成电路化学机械抛光关键技术与装备”项目荣获2023年度国家技术发明奖一等奖，是对公司核心研发团队在CMP领域技术创新成果的充分肯定，凸显了公司在CMP领域的科技实力。

3、强化产业链协同效应，加快新业务布局和重点项目建设

公司重视提升半导体设备及核心零部件的国产化程度，2024年上半年，公司围绕CMP、减薄等集成电路装备需求，重点培育关键零部件、核心材料等国产供应商，加快本土供应商培养，保证产品和技术的自主可控以及供应链安全。

2024年上半年，公司作为有限合伙人投资认购两支产业基金份额，借助专业投资机构在半导体等相关领域的资源优势和投资能力，进一步拓展公司产业布局，增强产业协同效应。同时，公司积极推动北京子公司及天津二期项目建设进度，均预计2024年年底竣工验收，将提高公司在湿法装备、减薄装备、化学机械抛光装备等半导体装备的研发和生产能力，进一步推动公司平台化战略布局，保障公司进一步巩固和扩大市场份额，从而提升公司核心竞争力。

二、提升精细化管理能力，持续保障上市公司经营业绩

公司的CMP装备凭借先进的产品性能、卓越的产品质量和优秀的售后服务在逻辑芯片、存储芯片、先进封装、大硅片、MEMS、MicroLED、第三代半导体等领

域取得了良好的市场口碑，市场占有率不断突破，2024 年上半年公司实现营业收入 149,651.89 万元，同比增长 21.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,265.14 万元，同比增长 15.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,825.70 万元，同比增长达 19.77%。同时公司持续优化现有生产、管理等内外部资源，进一步科学规范和优化设计研发、生产制造、客户服务、供应商管理等各环节流程，全面提升企业管理效能，全面持续深化精细化管理，降低企业运营成本，不断提升经营业绩，保证公司持续高质量健康发展。

三、重视股东投资回报，积极分享公司价值成长红利

1、现金分红

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。2024 年上半年，公司 2023 年年度股东大会审议通过了每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)的利润分配方案，截至本报告披露日，公司实施完成 2023 年度利润分配，共计派发现金红利 8,731.70 万元，占 2023 年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 12.06%，与广大股东共享公司发展红利。

2、股份回购

公司为维护股东投资价值、丰富投资者回报机制，2024 年上半年发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，拟以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的总金额开展股份回购，截至本报告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计使用 4,998.92 万元回购 318,860 股公司股份，占目前公司总股本的比例为 0.13%，将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。

四、提升信息披露质量，建立多元化沟通体系

公司始终严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时、公平，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。

1、持续提升信息披露质量

2024 年上半年，公司严谨、合规地开展信息披露工作，严格按照中国证监会、上海证券交易所等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，准确地为股东提供了投

资决策依据。同时，公司也进一步提高信息披露内容的可读性和易理解性，公司披露 2023 年年度及 2024 年第一季度报告后，在公司公众号发布可视化报告，并及时举行业绩说明会对公告内容进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

2、构建多元化沟通体系

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，2024 年上半年，公司持续构建多渠道、多平台、多方式的投资者关系管理体系，通过投资者热线、电子信箱等渠道与投资者高效沟通，并及时回应上证互动平台提问，保障投资者能够通过多元化平台与公司进行顺畅交流；同时组织投资者交流会、上市公司现场调研、业绩说明会等投资者交流活动，加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，使得广大投资者及时、公开、透明地了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等，加深投资者对公司的价值认知。

五、完善内部治理机制，持续提升公司治理水平

公司积极完善内部治理制度，2024 年上半年完成《公司章程》《独立董事工作制度》等 11 项制度的修订，提高公司运营的规范性和决策的科学性，为公司的高效、规范运行提供了制度保证，切实维护公司及全体股东利益。

公司加强了董监高培训工作，一方面整理发送新规修订解读，确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识，另一方面借助监管部门等培训平台资源，不断强化董监高合规意识，持续提升其履职能力，为公司高质量发展保驾护航。

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不断完善由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理架构，认真贯彻落实股东大会、董事会及管理层的各项决策，完成股份回购、年度授权、董监高换届等事项决策实施，统筹推进公司高质量发展。

六、压实“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

公司制定了经营业绩与高管报酬挂钩的薪酬考核制度，同时公司 2023 年限制性股票激励计划的归属条件也设置了每股收益、营业收入增长率、研发投入增长率等与投资者利益更为紧密的业绩考核目标，推动股东的利益共担和风险共享。根据 2024 年上半年公司披露的 2023 年年度报告及审计报告，公司超额完成设定

的 2023 年度业绩考核目标，每股收益、营业收入增长率均不低于 25 家对标企业 75 分位值。公司将持续强化管理层与股东的利益共担共享机制和“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司的长期稳定发展。

七、持续评估完善行动方案，共建高质量发展新生态

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，并将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 16 日